



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

CONSULTA PÚBLICA Nº 32 - SEI, 25 DE OUTUBRO DE 2022

A Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial SEPEC-ME/MCTIC nº 32, de 15 de julho de 2019, torna pública a proposta de alteração do Processo Produtivo Básico – PPB de “MODULADORES E DEMODULADORES PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS”.

O texto completo está disponível no sítio da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, no endereço:

<https://www.gov.br/produktividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/processo-produtivo-basico-ppb/consultas-publicas-de-ppb-1/consultas-publicas-de-ppb-2022>

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes e-mails: cgel.ppb@economia.gov.br, cgct.ppb@mcti.gov.br e cgpri.ppb@suframa.gov.br.

RODRIGO ZERBONE LOUREIRO

Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, substituto

ANEXO

PROPOSTA Nº 039 E Nº 040/2022 – ALTERAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA “MODULADORES E DEMODULADORES PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS”, ESTABELECIDO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL SEPEC/ME/SEXEC/MCTI nº 12.343 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL SEPEC/ME/SEXEC/MCTI nº 12.344, AMBAS DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.

1) Alteração do inciso I do §1º do art. 1º, conforme a seguir:

DE:

I - de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2022: 38 (trinta e oito) pontos;

PARA:

I - de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2022: **32 (trinta e dois)** pontos;

2) Alteração da redação das etapas descritas abaixo do Anexo das Portarias Interministeriais nº 12.343 e 12.344, de 2021:

Etapa VII

DE:

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de memória volátil do tipo RAM.

PARA:

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de memória volátil do tipo RAM, **quando não integradas às placas principais.**

Etapa VIII

DE:

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de memória não volátil do tipo FLASH.

PARA:

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de memória não volátil do tipo FLASH, **quando não integradas às placas principais.**

Etapa X

DE:

Montagem e soldagem de todos componentes nas placas que implementem a função de fonte de alimentação ou conversores CA/CC.

PARA:

Montagem e soldagem de todos componentes nas placas que implementem a função de fonte de alimentação ou conversores CA/CC, **quando não integradas às placas principais.**